

Bondexpo 2022

Bondexpo



Die Bondexpo gilt als Leitmesse der Klebetechnik und ist ein wichtiger Branchentreffpunkt für alle Aspekte des industriellen Fügens und Klebens.

Vom 4. bis 7. Oktober präsentieren sich die Aussteller auf dem Stuttgarter Messegelände, darunter auch Rehm Thermal Systems mit seinem Produktportfolio in den Bereichen Dosieren, Klebetechnologien und Applikationsverfahren. Mit dem klaren und konsequenten Fokus der Bondexpo auf die Prozesskette Fügen/Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen werden wirtschaftliche Detail- und Systemlösungen für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich des Fügens und Verbindens unterschiedlichster Materialien angeboten.

Beginn:

Dienstag, 4. Oktober 2022, 09:00 Uhr

Ende:

Freitag, 7. Oktober 2022, 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Stuttgart

Deutschland

Website & Anmeldung:

<https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine/detail/bondexpo.html>